

口腔修复学重要数字整理

1. 正常人的开口度：3.7—4.5cm
2. 下颌侧方运动下和最大侧方运动范围正常情况下约为 12mm
3. 牙松动幅度计算：一度松动幅度不超过 1mm，二度松动幅度为 1-2mm，三度松动幅度大于 2mm.
4. 一般拔牙后 1 个月后可进行可摘局部义齿. 全口义齿修复。拔牙 3 个月后进行固定义齿修复。
5. 修复时松动牙对于牙槽骨吸收达到根 2/3 以上，牙松动达三度者应拔除。
6. 健康成人牙槽骨嵴顶端位于釉牙骨质交界根尖方向 1.5mm 左右。
7. 前磨牙和第一磨牙近中接触区多在颊 1/3 与中 1/3 交界处，第一第二磨牙接触区在邻面中 1/3.
8. 修复体龈上边缘时止于距龈缘 2mm 处。边缘设计在沟内时一般在龈沟内 0.5mm 处
9. 牙体预备时聚合以 2-5 度为宜。
10. 嵌体洞缘一般在牙釉质内预备出 45 斜面，斜面一般起于釉质层的 1/2 处，宽度 1.5mm。面嵌体的牙体预备时洞形深度应大于 2mm，所有轴壁均应相互平行后向外展 2-5。邻嵌体鸠尾峡部一般不大于面的 1/2。高嵌体面外形均匀磨出至少 0.5-1mm 的间隙，磨牙常采用 4 个钉洞固位，钉洞深度一般为 2mm，直径 1mm。
11. 铸造全冠牙体预备聚合为 2-5，颌面预备一般为 0.5-1mm，肩台为 0.5-0.8mm
12. 烤瓷合金的熔点约为 1320℃，瓷粉熔点 871-1065℃，合金熔点必须高于瓷

粉熔点 170-270℃。高融合合金 >1100℃，低熔合金 <500℃。

13. 烤瓷冠预备量：前牙切端 1.5-2mm，唇侧 1.2-1.5mm，舌侧 0.8-1.5mm，唇侧肩台位于龈下 0.5-0.8mm，宽 1mm。后牙颌面 2mm，邻面 1.2-1.5mm，肩台 0.8-1.0mm

14. 桩冠预备一般要求根尖部保留 3-5mm 根充材料，桩的长度为根长的 2/3-3/4，理想的冠桩直径为根径的 1/3，上前牙直径为 1.5-2.5mm，下前牙为 1.1-1.5mm，上下后牙均为 1.4-2.7mm

15. 桩冠修复时机：无根尖周炎 3 天，有根尖周炎 1 周，外伤 1 周，窦道瘘管闭合以后，根尖手术 2 周。

16. 前牙 3/4 冠预备邻面向切端聚合 2-5°，预备间隙不少于 0.5mm。切斜面预备近远中方向形成平面，与牙长轴呈 45°角，预备出 0.35mm 以上的间隙。舌面有 0.5mm 间隙，邻沟预备从邻切线角的中点开始，方向与牙冠唇面切 2/3 平行，位于邻面唇 1/3 与中 1/3 交界处，深度为 1mm。切沟预备在斜面舌 1/3 处，做一顶角为 90°的沟，沟的唇侧壁高度是舌侧壁的 2 倍。

17. 后牙 3/4 冠面预备出 0.5-1mm 的间隙，沟预备先沿中央沟磨除宽深约

1.5mm×1.5mm 的沟，并与两邻面轴沟相连。邻沟预备在邻面颊侧 1/3 与中 1/3 交界处。

18. 固定义齿时倾斜 < 30°可做基牙。

19. 固定义齿修复的年龄 20-50 岁，最适合的年龄组为 30-45 岁。

20. 基牙选择时临床冠根比例以 1:2 至 2:3 较为理想，1:1 是选基牙的最低限度

21. 牙槽突的吸收超过根长的 1/3 就不宜选作基牙。

22. 固定连接体要求接触区接近切端或 $1/2$ 的部位，其面积不应小于 4m^2 。
23. 解剖式牙：牙尖斜度为 33° 或 30° 。
24. 非解剖式牙：牙尖斜度为 0° 。
25. 半解剖式牙：牙尖斜度约为 20° 。
26. 塑料基托一般厚度 2mm ，基托边缘厚度 2.5mm 。铸造基托厚度 0.5mm 。
27. 下颌基托后缘应覆盖磨牙后垫 $1/3-1/2$ 。
28. 铸造颌支托：宽度约为磨牙颊舌径的 $1/3$ 或双尖牙的颊舌径的 $1/2$ 。长度约为磨牙近远中径的 $1/4$ 或双尖牙的近远中径的 $1/3$ ，厚度为 $1-1.5\text{mm}$ 。弯制颌支托 18 号不锈钢扁钢丝，宽 1.5mm ，厚 1mm ，长 2mm 。
29. 圆形卡环常包绕基牙的 3 个面和 4 个轴面角。
30. 前腭杆：宽而薄，宽 8mm ，厚 1mm ，前缘离开龈缘至少 6mm 。
31. 后腭杆：窄而厚，宽 3.5mm ，厚 $1.5-2.0\text{mm}$ 。
32. 侧腭杆：宽 $3-3.5\text{mm}$ ，厚 $1-1.5\text{mm}$ ，离开龈缘约 $4-6\text{mm}$ 。
33. 卡环的数量不超过 4 个为宜，一般为 2-4 个固位体。
34. 舌杆：距龈缘 $3-4\text{mm}$ ，斜坡型者舌杆与粘膜离开 $0.3-0.4\text{mm}$ 。舌侧倒凹 $>6\text{mm}$ 不宜用舌杆。
35. 在游离缺失的缺失侧至少选择 2 个基牙。
36. 基牙的固位倒凹一般倒凹的深度应小于 1mm ，铸造卡环臂要求的倒凹深度偏小，不宜超过 0.5mm ，倒凹的坡度应大于 20° 。
37. 选托盘时与牙弓内外侧应有 $3-4\text{mm}$ 间隙，翼缘应距粘膜褶皱约 2mm 。
38. 全口排牙时上颌中切牙唇面至切牙乳突中点前 $8-10\text{mm}$ ，上颌两侧尖牙牙尖顶的连线应通过切牙乳突中点前后 1mm 范围内。

39. 上颌全口义齿的后缘应在腭小凹后 2mm 处。
40. 后堤区：宽 2-12mm，平均 8.2mm。
41. 下颌第一磨牙的颌面应与磨牙后垫的 1/2 等高。
42. 全口义齿托盘：上颌比上颌牙槽嵴宽 2-3mm，边缘高度应离开粘膜皱襞 2mm，，后缘超过颤动线 3-4mm。
43. 工作模型边缘厚度 3-5mm，模型最薄处也不能少于 10mm，后缘应在腭小凹后不少于 2mm，下颌模型在磨牙后垫自前缘起不少于 10mm。
44. 排牙时上和侧切牙切缘高于平面 1mm。
45. 下颌中切牙. 侧切牙和尖牙高于颌平面 1mm 。
46. 上颌第一前磨牙：舌尖离开颌平面 1mm。
47. 上颌第一磨牙：远舌尖. 近颊尖离开颌平面 1mm，远颊尖离开颌平面 1.5mm。
48. 上颌第二磨牙：舌尖离开颌平面 1mm，近颊尖离开颌平面 2mm，远颊尖离开颌平面 2.5mm。
49. 全口义齿直接法重衬时组织面均匀磨除 1mm。